

证券代码: 300657

证券简称: 弘信电子

公告编号: 2026-07

厦门弘信电子科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。

一、对外担保的进展情况

近日，公司全资子公司苏州市华扬电子有限公司（以下简称“华扬电子”）与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行”）签署《人民币流动资金贷款合同》，向中信银行申请流动资金贷款 2,500.00 万元。公司作为保证人，与中信银行签署《最高额保证合同》，为上述银行融资提供连带责任保证担保，担保金额为 2,500.00 万元。

二、合同主要内容

（一）公司与中信银行签署的《最高额保证合同》

- 1、担保人：公司；
- 2、债权人：中信银行；
- 3、担保金额：2,500.00 万元；
- 4、担保方式：连带责任保证；
- 5、担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限

于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等)和其他所有应付的费用;

6、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年；

三、累计对外担保情况

截止本公告披露之日，公司承担担保责任的对外担保总额为人民币 506,694.13 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 440.07%。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。

四、备查文件

1、公司与中信银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

厦门弘信电子科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 30 日